

北京赛微电子股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于对硅光市场前景的判断，为进一步巩固和提升在硅光代工领域的竞争力及市场地位，促进技术沉淀和未来市场拓展，下属香港全资子公司运通电子有限公司（英文名称 Global Access Electronics Limited，以下简称“运通电子”或“受让方”）与 IGSS Ventures Pte Ltd（以下简称“IGSS Ventures”或“转让方”）、CompoundTek Pte Ltd（以下简称“CompoundTek”或“标的公司”）签订了关于受让 CompoundTek 部分股权及硅光工艺技术转移的相关协议，运通电子以 CompoundTek 4,000 万美元的估值受让 IGSS Ventures 持有的 CompoundTek 10% 股权（以下简称“标的股权”），同时 CompoundTek 拟向公司香港全资子公司运通电子的指定方进行硅光工艺技术转移（以上交易统称“本次交易”），本次交易资金来源为自有资金，交易对价为 400 万美元。

2、截至本公告披露日，公司依据股权转让协议已完成本次交易第一期股权对价的支付，CompoundTek 完成了对应第一期交易价款的工商变更，但公司与相关方的硅光工艺技术转移备忘录尚未签订，第二期股权对价尚未支付，公司与相关方的硅光工艺技术转移能否推进、是否可适配市场需求，以及能否成功完成本地化转化与产业化应用均存在不确定性，相关技术在商业化过程中，也面临市场需求波动、行业技术迭代加速、市场竞争格局发生变化等事项；此外，本次交易涉及境外投资，需要境外商业环境、行业政策、投后管理等多方面的持续评估及跟踪。上述因素均有可能导致公司本次交易不能完全实现预期效果，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事长审议权限范围内，无需提交公司董事会或股东会审议。

一、交易概述

基于对硅光市场前景的判断，为进一步巩固和提升在硅光代工领域的竞争力及市场地位，促进技术沉淀和未来市场拓展，公司下属香港全资子公司运通电子与 IGSS Ventures、CompoundTek 签订了关于受让 CompoundTek 部分股权及硅光工艺技术转移的相关协议，运通电子以 CompoundTek 4,000 万美元的估值受让 IGSS Ventures 持有的 CompoundTek 10% 股权，同时 CompoundTek 拟向公司香港全资子公司运通电子的指定方进行硅光工艺技术转移，本次交易资金来源为自有资金，对价为 400 万美元。近日，公司（含下属香港全资子公司运通电子，下同）完成了本次交易第一期交易价款的支付，CompoundTek 完成了对应第一期交易价款的工商变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，在公司董事长审批权限范围内，无需公司董事会及股东会审议。

二、交易对手方基本情况

- 1、公司名称：IGSS Ventures Pte Ltd
- 2、登记证号码：201733148E
- 3、企业类型：私人有限公司
- 4、注册地址：5 International Business Park #02-07A Mewah Building Singapore 609914
- 5、法定代表人：Thiyaga Raj Kumar Tharumalingam
- 6、注册资本：1,350,954 新加坡元
- 7、成立时间：2017 年 11 月 17 日
- 8、主营业务：投资控股

9、股东情况：Thiyaga Raj Kumar Tharumalingam 持有 89.27%股权，其他股东持有 10.73%股权

IGSS Ventures 与公司不存在任何关联关系，与公司及公司前十大股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的公司基本情况

1、公司名称：CompoundTek Pte Ltd

2、登记证号码：201701028W

3、企业类型：私人有限公司

4、注册地址：5 International Business Park Mewah Building #02-07A
Singapore 609914

5、法定代表人：Thiyaga Raj Kumar Tharumalingam

6、注册资本：5000 新加坡元

7、成立时间：2017 年 1 月 10 日

8、主营业务：硅光虚拟晶圆厂服务

9、截至本公告披露日，标的公司股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	IGSS Ventures Pte Ltd	81.00%
2	Ang Kian Siong	11.00%
3	Thiyaga Raj Kumar Tharumalingam	7.00%
4	Zheng HaiQun	1.00%
合计		100.00%

本次交易完成后，标的公司股权结构如下（以实际交易方案为准）：

序号	股东名称	持股比例
1	IGSS Ventures Pte Ltd	71.00%
2	Ang Kian Siong	11.00%
3	Global Access Electronics Limited	10.00%
4	Thiyaga Raj Kumar Tharumalingam	7.00%
5	Zheng HaiQun	1.00%
合计		100.00%

10、主要财务数据

CompoundTek 截至 2025 年年底资产总额 7,005,977 新加坡元，负债总额

5,704,829 新加坡元，应收账款总额 1,348,009 新加坡元，净资产 1,301,148 新加坡元；2025 年营业收入 9,048,260 新加坡元，净利润-171,852 新加坡元，EBITDA 434,291 新加坡元，经营活动产生的现金流量净额 2,216,737 新加坡元（上述数据未经审计）。

CompoundTek 与公司不存在任何关联关系，与公司及公司前十大股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

四、交易协议的主要内容

（一）协议主体

受让方：运通电子有限公司

转让方：IGSS Ventures Pte Ltd

标的公司：CompoundTek Pte Ltd

（二）本次交易的方案

受让方以支付现金的方式购买转让方直接持有的标的合计 10% 的股权，转让方同意将标的股权转让给受让方。转让方及受让方同意，以标的公司价值 4,000 万美元进行作价，受让方应在协议条件满足情况下，依据协议就本次交易合计向转让方支付 400 万美元的对价。

本次交易各方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格主要通过合理协商的方式确定。公司本次以自有现金方式受让标的公司股权，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）本次交易的价款支付

转让方及受让方同意，本次交易转让的交易价款均以现金方式由受让方向转让方的指定银行账户进行支付，具体支付安排如下：

1、本次交易的第一期价款

自下列事项完成 20 日内，受让方向转让方支付第一期股权对价 200 万美元：

（1）签署本次交易转让协议；

（2）标的公司其他股东同意本次股权转让；

（3）本次交易已经获得所有签署并履行交易文件所需的第三方批准、授权或许可，且签署及履行交易文件不会违反任何适用法律或与任何第三方的协议或

约定；

(4) 标的公司董事会及/或股东会已通过决议，批准本次交易以及相关的公司章程修订；

(5)《股权转让协议》所约束成员与标的公司签署劳动合同、竞业禁止协议、保密协议及知识产权归属协议，前述协议约定前述人员全职受雇于标的公司，不得从事或投资与标的公司主营业务相同、相类似、相关联或相竞争的业务，对标的公司的知识产权及商业秘密负有保密义务，在职期间产生的知识产权所有权及申请权归属标的公司等内容。

(6) 自签署日至股份转让价款支付日期间，不存在且没有发生对标的公司的业务、资产、财务结构、负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况；

(7) 自签署日至股份转让价款支付日期间，各方在本协议项下所做的陈述与保证在所有重大方面均持续真实、准确、完整，且已履行本协议项下各项义务，未发生任何违约事件或潜在违约事件；

(8) 协议各方约定的其他事项。

2、本次交易的第二期价款

自下列事项完成 20 日内，受让方向转让方支付第二期股权对价 200 万美元：

(1) 标的公司与受让方的指定方签署相关硅光工艺技术转移备忘录；

(2) 标的公司已按硅光工艺技术转移备忘录要求完成全部事项；

(3) 自签署日至股份转让价款支付日期间，不存在且没有发生对标的公司的业务、资产、财务结构、负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况；

(4) 自签署日至股份转让价款支付日期间，各方在本协议项下所做的陈述与保证在所有重大方面均持续真实、准确、完整，且已履行本协议项下各项义务，未发生任何违约事件或潜在违约事件；

(5) 协议各方约定的其他事项。

(四) 本次交易的交割

转让方收到的每一期款项均应构成股权转让价款的一部分，每一期款项的支付均构成受让方对该期款项支付义务的完全且最终履行，转让方应在收到每一期款项 20 个工作日内充分配合，办理该期款项对应股权的股权变更及新加坡会计

与企业管理局的登记事宜。任何一期股权转让价款支付条件未达成的，则当期及后期股权转让价款不再支付，相应股权不再转让。

（五）标的公司的治理

本次交易后标的公司董事会由最多六名董事构成，其中受让方有权提名一名董事，由股东会选举产生。标的公司董事会设董事长一名，由 IGSS Ventures 提名，并由董事会选举产生。

（六）违约责任

除不可抗力外，协议项下任何一方因违反协议规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使协议不能全部履行、部分不能履行或不能及时履行，并由此给守约方造成损失的，该违约方应当承担违约责任并赔偿守约方的实际损失。

（七）合同的生效、变更和终止

1、各方同意，协议在各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、协议的任何修改和变更均应采取书面形式，协议的修改和变更是协议不可分割的组成部分，与协议具有同等法律效力。

3、协议应在协议中规定的所有权利和义务履行完毕时终止，但其亦可因下列任一情形而提前终止：

（1）一方根据法律法规的规定或本协议的约定解除或终止本协议；

（2）各方协商一致同意提前解除或终止本协议。

五、涉及购买、出售资产的其他安排

本次交易不存在法律法规之外其他限制股东权力的条款；本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不会因本次交易产生新的关联方和关联交易，不会与关联人产生同业竞争情形。公司在本次交易完成后继续与控股股东及其关联人在人员、资产、财务等方面保持独立。

六、本次交易的目的和对公司的影响

近年来，伴随着 AI 数据中心算力的不断增长，高速率光模块需求旺盛，硅光技术凭借低成本、低功耗和高集成度的优势，逐渐成为高速率光模块的主流技术路径。当前，硅光行业正处在技术追赶和产业化的关键期，为国内厂商进入供

应链提供了宝贵的战略窗口。为积极把握半导体特色工艺制造产业机遇，丰富和拓展公司在硅光领域的工艺布局，促进公司业务的进一步发展，提高公司竞争力，公司决定开展本次交易。

公司旨在通过本次交易积极进行半导体产业投资布局，形成可支持“内循环”、兼顾“双循环”的半导体服务体系，实现资源互补、业务联动与协同发展，本次交易符合公司的发展战略；同时，公司后续合作若得以顺利推进，将巩固和提升公司在硅光代工领域的竞争力及市场地位，促进公司在硅光领域的技术沉淀和经验积累；此外，公司未来有望通过合作，挖掘市场需求及拓宽业务覆盖面，把握硅光芯片代工需求增长的机遇，新增合作机会，促进公司业务的进一步发展。

七、本次交易存在的风险

截至本公告披露日，公司依据股权转让协议已完成本次交易第一期股权对价的支付，CompoundTek 完成了对应第一期交易价款的工商变更，但公司与相关方的硅光工艺技术转移备忘录尚未签订，第二期股权对价尚未支付，公司与相关方的硅光工艺技术转移能否推进、是否可适配市场需求，以及能否成功完成本地化转化与产业化应用存在不确定性，相关技术在商业化过程中，也面临市场需求波动、行业技术迭代加速、市场竞争格局发生变化等事项；此外，本次交易涉及境外投资，需要境外商业环境、行业政策、投后管理等多方面的持续评估及跟踪。上述因素均有可能导致公司本次交易不能完全实现预期效果，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

《股权转让协议》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026年4月30日